

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	华创证券、中泰证券、银华基金
时间	2024年10月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2024 年前三季度经营情况</p> <p>随着消费类电子市场回暖及新能源汽车电子技术升级，加上 AI 服务器在内的算力产业链需求强劲，拉动了下游客户的资本支出，公司相应的专用加工设备销售增长显著。2024 年前三季度，公司实现营业收入 234,358.46 万元，较上年同期增长 105.55%，归属于上市公司股东的净利润 20,302.90 万元，较上年同期增加 27.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,888.54 万元，较上年同期增加 35.56%。</p> <p>二、公司所处行业情况</p> <p>2024 年以来，随着消费电子终端库存逐步消化，电子产业走出低谷，加上 AI 算力需求爆发的推动，PCB 产业重回成长通道；从长期来看，AI 算力产业链从数字基建到应用终端逐步发展，对高速通讯设备、高端 AI 服务器、大型数据中心等基础设施及 AI 手机、AI PC 的需求显著增加，AI 相关电子终端产品已成为 PCB 产</p>

业发展的新一轮推动要素，未来大尺寸封装基板、高多层板及 HDI 板等产品的需求增加将带动行业的持续投资，促进专用加工设备市场的不断成长；另一方面，受电动化、智能化驱动，汽车相关电子零部件成本占比大幅攀升，拉动整车的 PCB 需求量，共同推动 PCB 产业长期向好发展。

三、多层板及高多层板市场业务情况

在竞争最为激烈的多层板市场，客户降本增效需求持续。公司推出的第二代钻房自动化方案，加上高功率阻焊激光直接成像系统、自动上下料机机械成型机、电测与自动外观检查一体机、自动分拣包装机等自动化、数字化、智能化的解决方案，可大幅降低下游客户的人力成本支出，提升客户端设备稼动率及产品品质，受到客户的高度认可。

而在高多层板市场，针对 AI 服务器、高速交换机等终端采用更高层数、更高密度的高速多层板，公司推出的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机、高功率及能量实时监测的 CO₂ 激光钻孔机、高性能激光直接成像系统、大台面六倍密通用测试机及 CCD 四线测试机等系列产品，可充分满足服务器等大厚板高品质、高可靠性加工，确保高速 PCB 的信号完整性，助力下游客户快速进入增长强劲的高多层板市场，提升公司在该市场的营收水平。

四、HDI 及封装基板市场拓展情况

在传统及任意层 HDI 市场，HDI 板的特征尺寸进一步微缩，公司持续升级四光束 CO₂ 激光钻孔机、高解析度激光直接成像系统及高精测试机等产品性能，以满足该市场不断提升的技术要求。另外，AI 智能手机及光模块越来越多采用类载板，带动了微小盲孔等高精度加工专用设备需求，公司提供新型激光加工方案，可满足微小孔钻孔及超高精度外型的成型加工要求，为行业新兴应用提供新动力。

针对大尺寸 FC-BGA 高阶封装基板 ABF 增层数增加及特征尺寸变小等特点，公司创新运用新型激光加工技术，开发出用于先进封装基板的多制程成套加工方案，相关设备及工艺方案已获得行业头部客户的认证及正式订单，未来公司高附加值 PCB 加工设备的销售占比将进一步提升。

	<p style="text-align: center;">五、公司的发展战略规划</p> <p>公司始终围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB（装备）服务商”的战略愿景，积极把握 PCB 生产制造的自动化、智能化发展趋势，强化技术创新投入，不断开发具有行业领先水平的创新型产品。一方面，公司将持续深挖多层板市场价值，加大创新研发力度，打造超越客户预期的优化解决方案，并通过产业链上下游价值发现机制，不断拓宽公司产品矩阵，持续放大公司在该市场的价值；另一方面，公司聚焦市场增速快、技术门槛更高的 HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等领域，发挥多产品、多场景的协同优势，研发适应不同细分市场需求的、具有市场竞争力的覆盖 PCB 生产全流程的智能制造解决方案，不仅要从产品性能层面打破国外的技术垄断，更要从 PCB 全流程智造的维度实现对国外技术的赶超。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 22 日